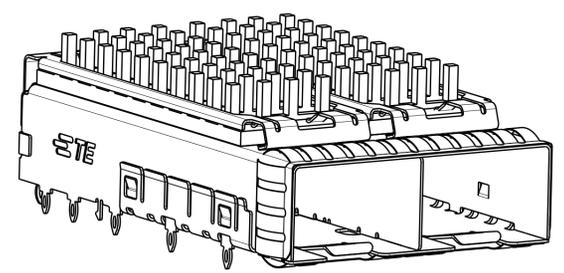
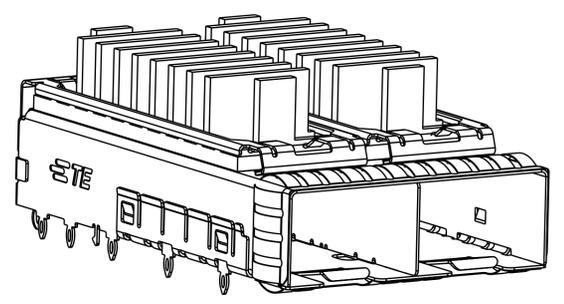


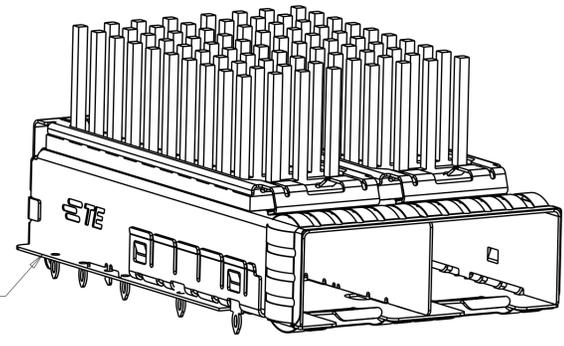
LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		B		REVISED PER ECR-18-002882	27FEB2018	IT	SH



2198230-1, 2, 3, 4
FINISHED ASSEMBLY WITH
PIN TYPE HEAT SINK



2198230-5, 6, 7, 8
FINISHED ASSEMBLY WITH
FIN TYPE HEAT SINK



PCB GASKET

1-2198230-4
FINISHED ASSEMBLY WITH
PIN TYPE HEAT SINK, WITH BELLY GASKET

△ MATERIAL:
 CAGE ASSEMBLY:
 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
 EMI SPRINGS: COPPER ALLOY
 HEAT SINK: ALUMINUM
 HEAT SINK CLIP: STAINLESS STEEL.

△ FINISH:
 HEAT SINK: ELECTROLESS NICKEL
 HEAT SINK CLIP: PASSIVATE.
 EMI SPRINGS: 0.8µm MIN MATTE TIN OVER
 0.8µm MIN NICKEL, NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.

△ DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

△ PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.

5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT RECIEVERS.

6. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OR ASME Y14.5M-1994.

△ MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
 SINGLE SIDED: 1.5mm
 DOUBLE SIDED: 2.25mm

△ HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT, SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.

△ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

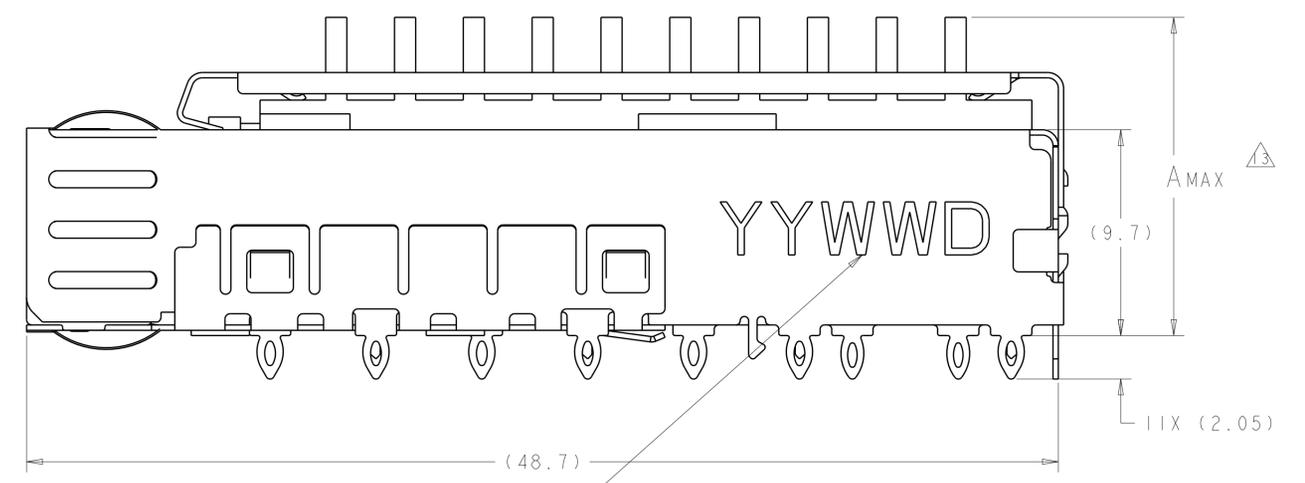
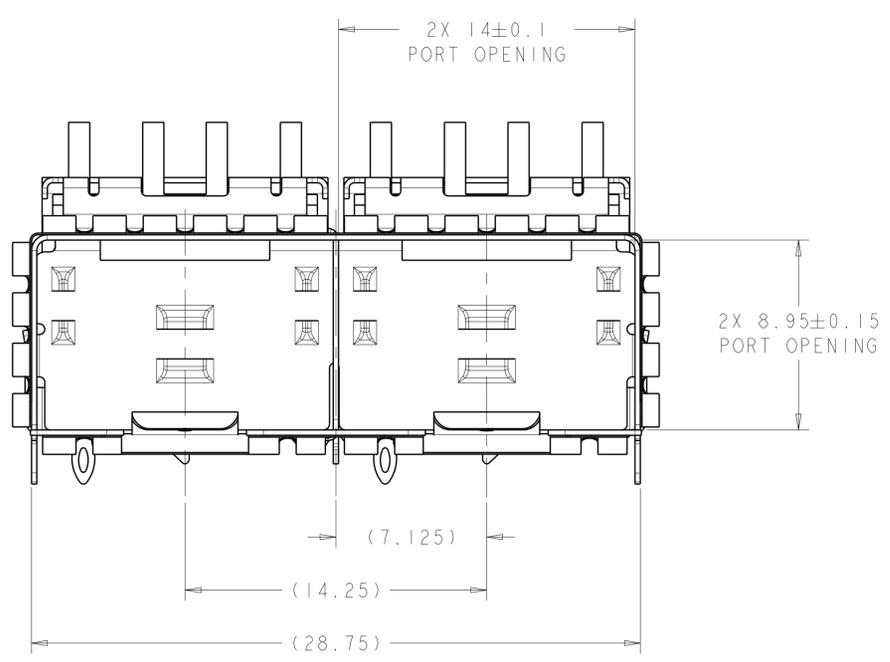
△ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

11. CERTAIN MATING TRANCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD NEED TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.

12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.

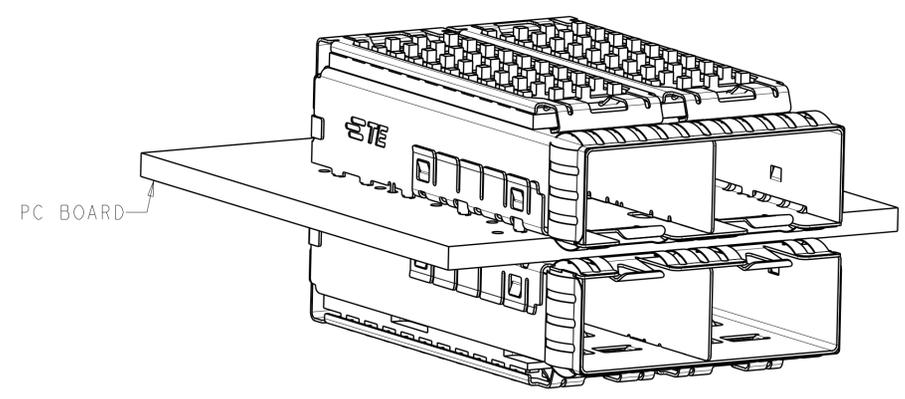
△ DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.

△ WITH BELLY GASKET: RF ABSORBER



APPROXIMATE LOCATION OF DATE CODE

FIN TYPE	DESCRIPTION	PART NUMBER
FIN TYPE 22.5	NETWORKING, TALL	2198230-8
FIN TYPE 18.1	NETWORKING, SHORT	2198230-7
FIN TYPE 15.5	SAN	2198230-6
FIN TYPE 13.2	PCI	2198230-5
PIN TYPE 22.5	NETWORKING, TALL	1-2198230-4
PIN TYPE 22.5	NETWORKING, TALL	2198230-4
PIN TYPE 18.1	NETWORKING, SHORT	2198230-3
PIN TYPE 15.5	SAN	2198230-2
PIN TYPE 13.2	PCI	2198230-1
HEAT SINK	DESCRIPTION	PART NUMBER



PC BOARD

2198230-1
MOUNTED BELLY TO BELLY
SCALE 3:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN: C. VALENTINE 06OCT2011
 CHK: M. SCHMITT 06OCT2011
 APVD: M. SCHMITT 06OCT2011

STE TE Connectivity

NAME: SFP+ ENHANCED 1X2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EMI SPRINGS, HEAT SINK

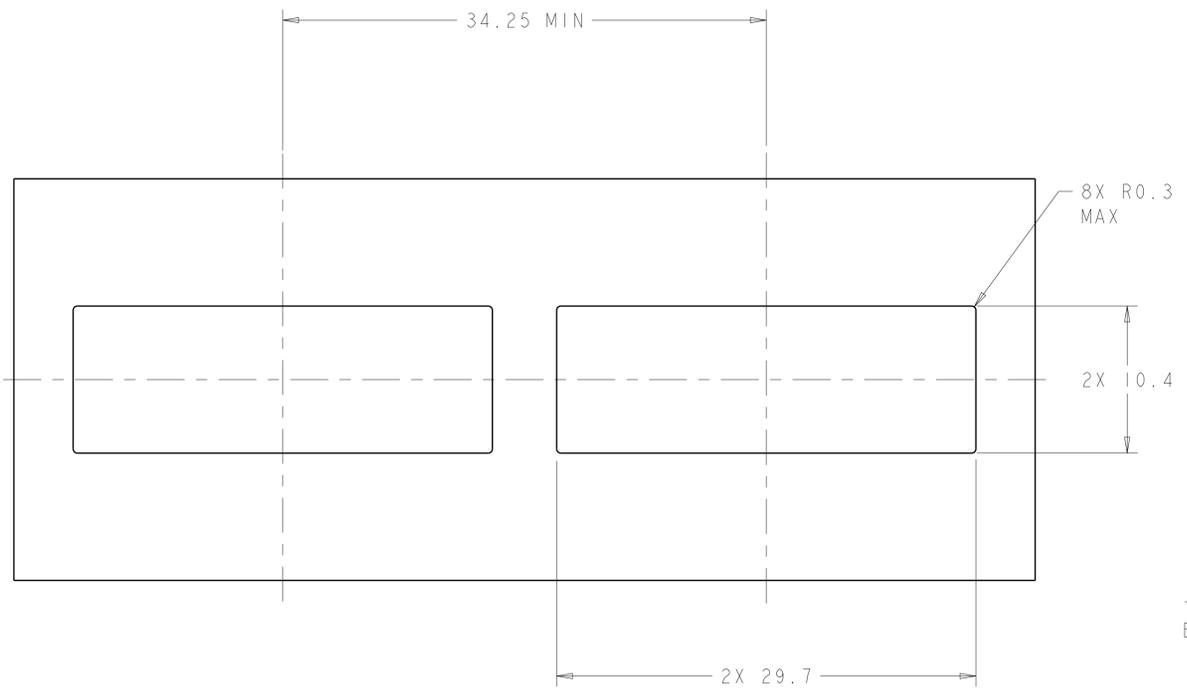
PRODUCT SPEC: 108-2364
 APPLICATION SPEC: 114-13120

SIZE: A1
 CAGE CODE: 00779
 DRAWING NO: C=2198230

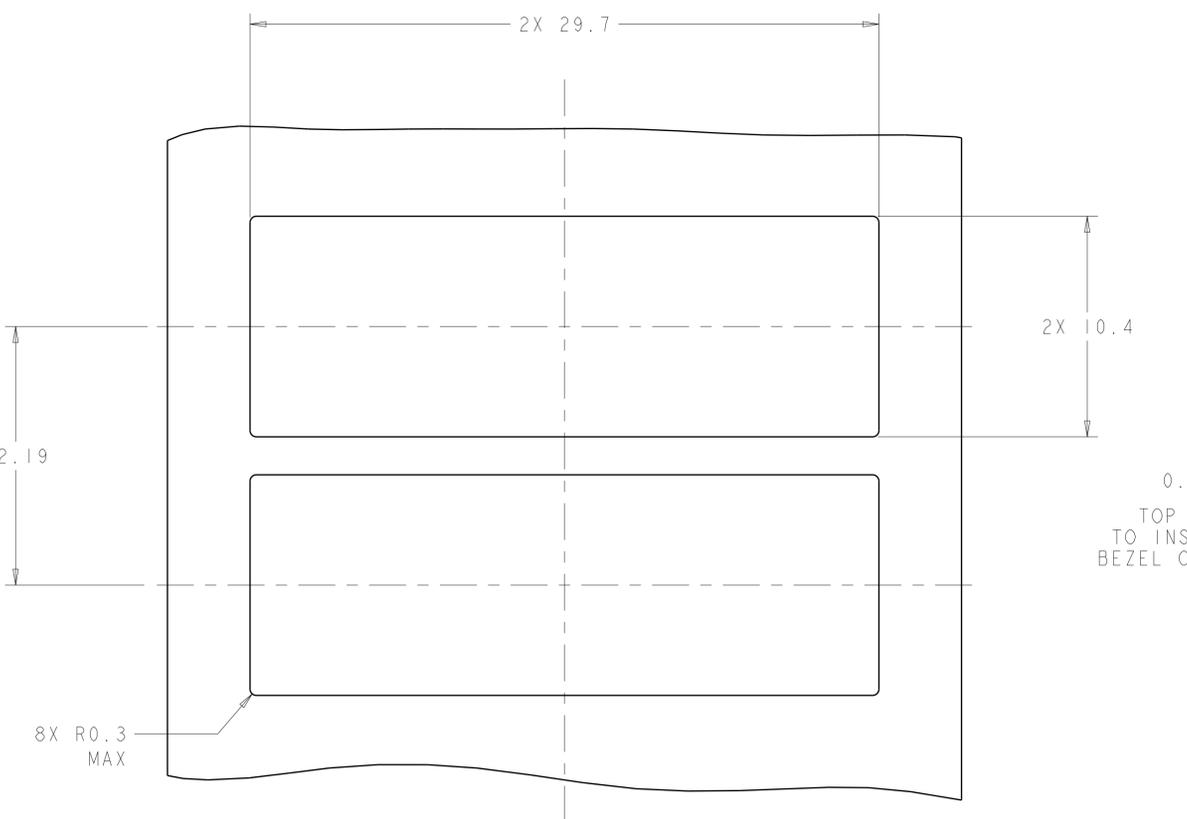
RESTRICTED TO: -

Customer Drawing SCALE 2:1 SHEET 1 OF 4 REV B

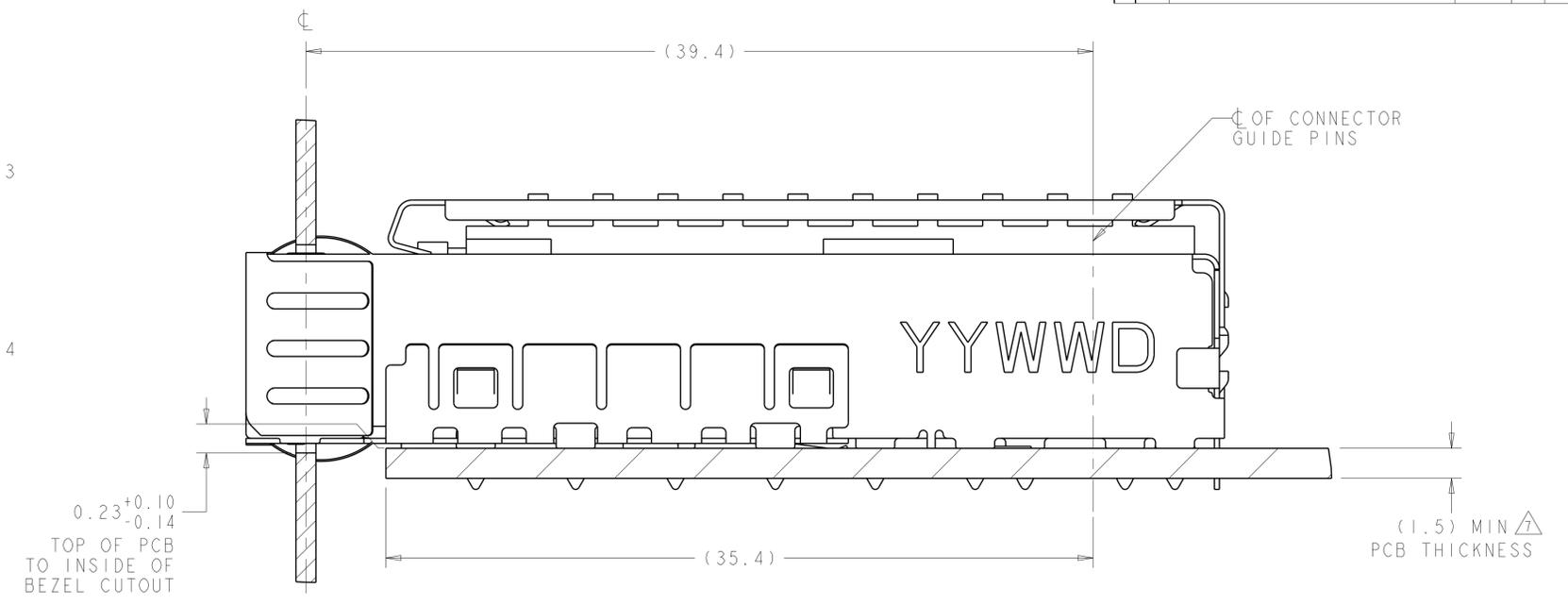
LOC		DIST		REVISIONS			
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



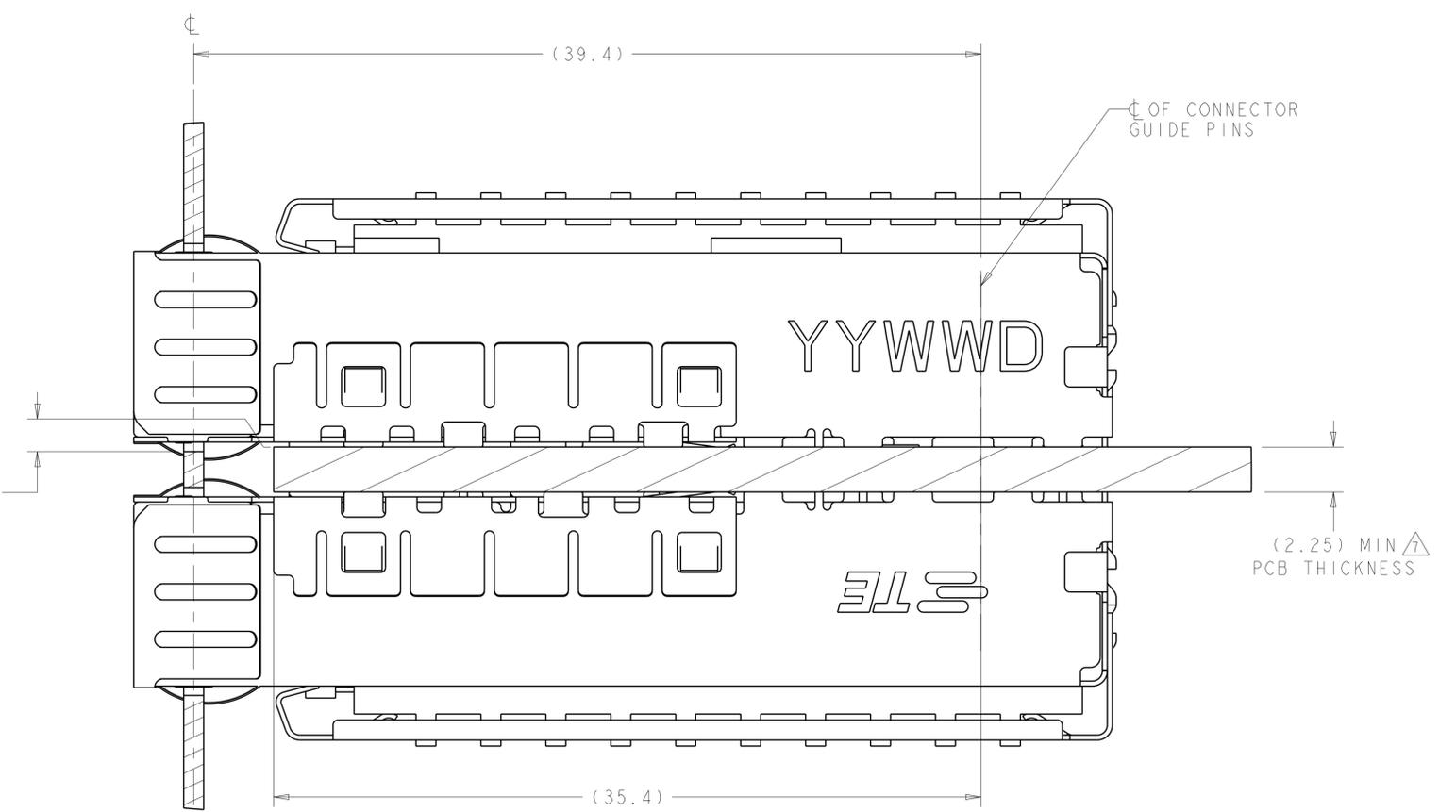
RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
 SINGLE SIDED APPLICATIONS
 SCALE 4:1



RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
 BELLY TO BELLY APPLICATIONS



2198230-1
 MOUNTED ON PC BOARD
 SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL



2198230-1
 MOUNTED BELLY TO BELLY ON PC BOARD
 SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DMN C. VALENTINE 06OCT2011	 TE Connectivity
DIMENSIONS:		CHK M. SCHMITT 06OCT2011	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M. SCHMITT 06OCT2011	NAME SFP+ ENHANCED 1X2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EMI SPRINGS, HEAT SINK
mm	0 PLC ±0.13	PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
	1 PLC ±0.1	108-2364	A100779C=2198230
	2 PLC ±0.08	APPLICATION SPEC	SCALE 6:1 SHEET 2 OF 4 REV B
MATERIAL	3 PLC ±0.05	114-13120	
	4 PLC ±0.05	WEIGHT	
ANGLES	±0.5	Customer Drawing	
FINISH	±0.1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9